

新闻消息

Viscom 智能 3D AXI @ Nepcon 电子制造梦工厂

上海，2018 年 8 月——NEPCON 华南电子展，展位号：1E45 在即将举行的 NEPCON 华南电子展会上，作为展示智能制造的一部分，Viscom 将在‘电子制造梦工厂创新展示区’展出其先进的 3D AXI 检测技术，Viscom 还与 IPC Connected Factory Exchange (CFX) 合作，并将通过其强大的 3D AOI, 3D MXI, 和 3D AXI 在展位上展现真正的智能化生产工业 4.0——1E45

作为在 SMT 检测中实施智能工厂解决方案的先驱，Viscom 为工业 4.0 做好准备。并决心进一步优化 SMT 生产线，以获得最为稳定高效的工艺流程。为了实现这一目标，Viscom 提供了一系列智能操作界面和软件工具，这些智能操作界面和软件工具可以自动链接来自检测系统的检测信息进行分析，并在需要时轻松地与第三方系统交换信息。参观者可以在电子制作梦工厂创新展示区 1T40 展位上了解到智能化生产的真实运作流程及



方式，并观看到整个生产过程的交互方式。参观者可以在他们的智能手机上订购个性化的样品产品，并跟踪整个生产过程。在 Viscom 的展台上，参观者还可以亲身体验进一步的工业 4.0 应用。Viscom 与 IPC Connected Factory Exchange (CFX) 倡议合作，将他们的系统连接到 CFX 云端，通过该云端，来自 Viscom 机器的标准化 IoT 数据被传输到访客的个人移动设备。参观者可以实时查看实时分析报告，如 OEE (总体设备有效性)、单位计数以及显示系统上发生的实际事件的实时数据流。

新一代 3D AXI @ 交联智能

与所有 Viscom 系统一样，新的 X7056-II 3D 在线 AXI 被开发成无缝集成到生产线中，并促进智能交联工业 4.0 和智能工厂应用。X7056-II 3D AXI 是 Viscom 非常成功的 X7056 系列中全新重新设计的后继产品，X7056 系列得到了世界上最先进的电子制造商的广泛认可。它具有创新的硬件和软件功能，并且在德国获得了著名的 productronica 创新奖以及在美国获得了新产品介绍奖。配备创新的 xFastflow 高速处理系统，X7056-II 现在能够同时处理 3 个 PCB，从而将处理时

间（进板和出板）缩短到 4 秒以内。由于节省了时间，3D 检测在原来单个选择的基础上大大得到了扩展。更短的检测时间和出色的检测结果可降低成本、提高产量并减少产品报废，从而最大程度地降低不必要的高报废量造成的环境影响。此外，通过最先进的平面 CT 软件算法，可以对焊点进行高度精确的 3D 数字重建。最有效地减少干扰结构。通过切片可以方便地提取具有复杂部件重叠的双面 PCB 的层，并且可以比以往更加精确和容易地揭露缺陷。因此，X7056-II 的出现是检验质量和速度的重大突破，也是与智能工厂应用相结合提出强大且经得起未来考验的解决方案的重大突破。

Viscom AG

Viscom 开发、制造、销售高性能的、工业化生产所需的自动化检测系统。其产品覆盖自动光学和自动 X 光检测领域系列产品。在电子制造元件检测领域，该企业是全球领先的顶尖供应商。Viscom 检测设备可根据客户需求进行设置和连接。公司总部及生产基地位于德国汉诺威。通过建立公司分部、应用中心、服务网点和代表处，Viscom 在全球范围建立了销售和服务网络。Viscom 成立于 1984 年，于 2006 年在法兰克福证券交易所上市 (ISIN: DE0007846867)。进一步信息详见 www.viscom.de